

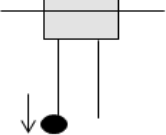
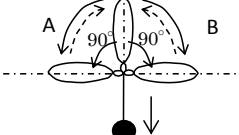
Test Sheet of Leaded MLCC for General Purpose RDE series [Temperature Compensating Type]

Data No.:RTD-H0791E

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Typical Murata Global Part No	Temp. Chara.	Cap.Value	Cap.Tol.	Volt.
RDE7U2J943JU**H***	U2J	94nF	±5%	630V

Operating Temperature Range / 使用温度範囲 : -55 ~ +125°C

Tested Item/ 試験項目	Tested Condition/ 試験条件	Result/試験結果 (Rejection Number/Sample Number)															
1.Terminal Strength / 端子強度	Tensile Strength/引っ張り強さ  Keeping Time / 保持時間 : 10±1s Tensile Force / 引張力 : 10N Bending Strength/曲げ強さ  Bending direction / 曲げ方向 : A and B Bending time / 90°曲げに要する時間 : 2 to 3s. Weight / 荷重 : 2.5N	0/10															
2.Vibration Resistance/ 耐振性	Oscillation Frequency/振動周波数 : 10Hz to 55Hz to 10Hz for 1min. Total Amplitude/全振幅 : 1.5 mm Time/時間 : A period of 2 hrs. in each of 3 mutually perpendicular directions. (Total 6 hours)/垂直3方向に各2時間(計6時間)	0/10															
3.Solderability of Termination / はんだ付け性	Temp. of solder/はんだ温度 : 245±5°C (Lead Free Solder/無鉛はんだ [Sn-3.0Ag-0.5Cu]) Temp. of solder/はんだ温度 : 235±5°C (H60A or H63A Eutectic Solder/共晶はんだ) Immersion Time/浸せき時間 : 2±0.5s Depth of dipping/ 浸せき位置 : Up to about 1.5mm to 2mm from the terminal body/ 本体根元から1.5~2.0mm の所まで	0/10															
4.Resistance to soldering Heat (Non-Preheat)/ はんだ耐熱性 (予熱なし)	Temp. of solder/はんだ温度 : 260±5°C Immersion Time/浸せき時間 : 10±1s Depth of dipping/ 浸せき位置 : Up to about 1.5mm to 2mm from the terminal body/ 本体根元から1.5~2.0mm の所まで Post-treatment/後処理 : Place at room condition for 24±2hrs.	0/10															
5.Temperature Cycle/温度サイクル	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Step</th><th>Temperature(°C)</th><th>Time(min)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Min. Operating Temp.±3</td><td>30±3</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Room Temp.</td><td>3 max.</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Max. Operating Temp.±3</td><td>30±3</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Room Temp.</td><td>3 max.</td></tr> </tbody> </table> Temperature cycle/温度サイクル : 5 cycles Post-treatment/後処理 : Place at room condition for 24±2hrs.	Step	Temperature(°C)	Time(min)	1	Min. Operating Temp.±3	30±3	2	Room Temp.	3 max.	3	Max. Operating Temp.±3	30±3	4	Room Temp.	3 max.	0/10
Step	Temperature(°C)	Time(min)															
1	Min. Operating Temp.±3	30±3															
2	Room Temp.	3 max.															
3	Max. Operating Temp.±3	30±3															
4	Room Temp.	3 max.															
6.Humidity (Steady State)/ 耐湿性	Temperature/温度 : 40±2°C Relative humidity/相对湿度 : 90%~95%(RH) Duration/試験時間 : 500+24/-0hrs. Post-treatment/後処理 : Place at room condition for 24±2hrs.	0/10															
7.Humidity Load/ 耐湿負荷	Temperature/温度 : 40±2°C Relative humidity/相对湿度 : 90%~95%(RH) Duration/試験時間 : 500+24/-0hrs. Applied voltage/印加電圧 : Rated voltage Post-treatment/後処理 : Place at room condition for 24±2hrs.	0/10															
8.High Temperature Load/ 高温負荷	Temperature/温度 : Max. Operating Temp.±3°C Applied voltage/印加電圧 : 120% of the rated voltage Duration/試験時間 : 1000+48/-0hrs. Post-treatment/後処理 : Place at room condition for 24±2hrs.	0/10															

Note: These test condition and specification are for the typical item.

Typical Murata Global Part No	Temp. Chara.	Cap.Value	Cap.Tol.	Volt.
RDE7U2J943JU**H***	U2J	94nF	±5%	630V

—○— AVE. ■ MAX. ■ MIN.

Tested Item/ 試験項目	Confirmed Criteria/ 評価項目	Specification and Result / 規格値 および 試験結果				
1.Terminal Strength / 端子強度	Appearance/外観	Termination not to be broken or loosened. 端子の破壊、緩みなどの異常 はありません。	OK			
2.Vibration/ 耐振性	Appearance/外観	No defects /著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance/ 静電容量	89.3 to 98.7 nF				
	Q	1000 (min.)				
3.Solderability of Termination / はんだ付け性	Wetting area/ はんだ付き面積	Solder is deposited on unintermittently immersed portion in axial direction covering 3/4 or more in circumferential direction of lead wires. リード線の円周方向3/4 以上 で軸方向に切れ目がなく、浸し た所まではんだが付着してい ます。	OK			
4.Resistance to soldering Heat (Non-Preheat)/ はんだ耐熱性 (予熱なし)	Appearance/外観	No defects /著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change/ 静電容量変化率(%)	±2.5% (within)				
	Dielectric Strength (Between terminals)/ 耐電圧(端子間)	No defects/異常ありません。	OK			
5.Temperature Cycle/ 温度サイクル	Appearance/外観	No defects /著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change/ 静電容量変化率(%)	±5% (within)				
	Q	350 (min.)				
	IR/絶縁抵抗(MΩ)	5.3E+02(min.)				
	Dielectric Strength (Between terminals)/ 耐電圧(端子間)	No defects/異常ありません。	OK			
6.Humidity (Steady State)/ 耐湿性	Appearance/外観	No defects /著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change/ 静電容量変化率(%)	±5% (within)				
	Q	350 (min.)				
	IR/絶縁抵抗(MΩ)	5.3E+02(min.)				
7.Humidity Load/ 耐湿負荷	Appearance/外観	No defects /著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change/ 静電容量変化率(%)	±5% (within)				
	Q	200 (min.)				
	IR/絶縁抵抗(MΩ)	2.7E+02(min.)				
8.High Temperature Load/ 高温負荷	Appearance/外観	No defects /著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change/ 静電容量変化率(%)	±3% (within)				
	Q	350 (min.)				
	IR/絶縁抵抗(MΩ)	5.3E+02(min.)				
	Dielectric Strength/ 耐電圧	No defects/異常ありません。	OK			